

证券简称：联得装备

股票代码：300545



深圳市联得自动化装备股份有限公司

Shenzhen Liande Automation Equipment Co.,Ltd.

(广东省深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层)

创业板向特定对象发行A股股票 募集说明书（修订稿）

保荐人（主承销商）



东方证券
ORIENT SECURITIES

投资银行

东方证券承销保荐有限公司
ORIENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD

(上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层)

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

第一节 释义	5
一、普通术语	5
二、专业术语	6
第二节 发行人基本情况	9
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况	9
二、所处行业的主要特点及行业竞争情况	11
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容	19
四、现有业务发展安排及未来发展战略	28
五、公司财务性投资情况	29
第三节 本次证券发行概要	31
一、本次发行的背景和目的	31
二、发行对象及与发行人的关系	38
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	43
四、募集资金投向	44
五、本次发行是否构成关联交易	45
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	45
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ..	46
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	47
一、募集资金使用计划	47
二、募集资金项目的可行性分析	47
三、募集资金投资项目概况	54
四、本次非公开发行对公司的影响	60
第五节 本次募集资金收购资产的有关情况	61
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	62
一、对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的 影响	62
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动分析	62
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同	

业竞争等变化情况	63
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	63
第七节 与本次发行相关的风险因素	64
一、募集资金投资项目实施风险	64
二、行业竞争加剧的风险	64
三、受下游市场波动影响的风险	64
四、财务风险	65
五、管理风险	65
六、即期回报被摊薄的风险	65
七、审批风险	65
八、应收账款金额不断扩大的风险	66
九、存货管理的风险	66
第八节 与本次发行相关的声明	67
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	68
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	69
二、控股股东、实际控制人声明	70
三、保荐机构（主承销商）声明	71
三、保荐机构（主承销商）声明（二）	72
四、发行人律师声明	73
五、会计师事务所声明	74
第九节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	75
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	75
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	75

第一节 释义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

一、普通术语

发行人、公司、联得装备、股份公司	指	深圳市联得自动化装备股份有限公司
联得有限	指	深圳市联得自动化机电设备有限公司
东莞联鹏	指	东莞联鹏智能装备有限公司
衡阳联得	指	衡阳市联得自动化机电设备有限公司
苏州联鹏	指	苏州联鹏自动化设备有限公司
日本子公司	指	Liande J R&D 株式会社
股票或 A 股	指	每股面值为人民币 1.00 元的普通股
本次发行	指	发行人本次非公开发行 A 股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上市	指	发行人股票获准在交易所上市
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、主承销商	指	东方证券承销保荐有限公司
发行人律师	指	广东信达律师事务所
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月
苹果	指	Apple Inc.及其控制的公司
富士康	指	富士康科技集团及其控制的公司
华为	指	华为技术有限公司及其控制的公司
TPK	指	宸鸿科技集团及其控制的公司

京东方	指	京东方科技集团股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 000725.SZ）及其控制的公司
南玻	指	中国南玻集团股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 000012.SZ）及其控制的公司
深天马	指	天马微电子股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 000050.SZ）及其控制的公司
超声电子	指	广东汕头超声电子股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 000823.SZ）及其控制的公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 002594.SZ）及其控制的公司
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 002475.SZ）及其控制的公司
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 002387.SZ）及其控制的公司
欧菲科技	指	欧菲科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 002456.SZ）及其控制的公司
长信科技	指	芜湖长信科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 300088.SZ）及其控制的公司
蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 300433.SZ）及其控制的公司
日本东丽	指	日本东丽工程株式会社
日本 TEL	指	东京电子株式会社
日本芝浦	指	日本芝浦科技株式会社
正业科技	指	广东正业科技股份有限公司
集银科技	指	深圳市集银科技有限公司
智云股份	指	大连智云自动化装备股份有限公司
鑫三力	指	深圳市鑫三力自动化设备有限公司
旭东机械	指	旭东机械工业股份有限公司
易发精机	指	易发精机股份有限公司
易天股份	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司（深交所上市公司，股票代码 300812.SZ）及其控制的公司
华洋精机	指	华洋精机股份有限公司

二、专业术语

平板显示器件	指	依靠矩阵点或线段控制并激励屏幕发光，呈现信息供视觉感受的器件。
FPD	指	Flat Panel Display 的缩写，平板显示器，体积小、重量轻的薄形电

		子显示器，它以液晶显示器、等离子体显示器和有机电致发光显示器为代表，它可分为主动发光型和非主动发光型两类。
显示模组	指	显示屏等显示器件成品的主要部件之一，由线路板、驱动芯片、电阻等组成。
液晶模组	指	LCM (Liquid Crystal Module)，将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。
液晶显示	指	一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示方式。
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示器，由液态晶体组成的显示屏，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源在平面面板上产生图象。
TP	指	Touch panel 的缩写，即触摸屏，一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，主要有电阻式、电容式、表面超声式、红外式等。
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发光特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光，而且 OLED 显示屏幕可视角度大且能够显著节省电能。
TFT	指	Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。
背光模组	指	液晶显示器面板的关键零组件之一，功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。
基板	指	制作显示器件用的衬底基材，通常有软基板和硬基板。
偏光片	指	也叫偏振光片，是指能使按特定方向振动的光线通过，而不能使其他振动方向的光线通过或通过率极小的一种片材。
FPC	指	Flexible Printed Circuit 的缩写，即柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。
ACF	指	Anisotropic Conductive Film 的缩写，异方导电膜，即水平方向不导电、垂直方向导电，具有导电和粘性的特性。
OCA	指	Optically Clear Adhesive 的缩写，固态光学透明胶，用于胶结透明光学元件的特种粘胶剂，一般用作基板之间的贴合介质。
ITO	指	Indium Tin Oxide 的缩写，氧化铟锡，一种半导体材料，具有高的导电率、高的可见光透光率、高的机械硬度和良好的化学稳定性。ITO 膜层的厚度不同，膜的导电性能和透光性能也不同。
AOI	指	Automatic Optic Inspection 的缩写，自动光学检测，是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。
FOG	指	FPC On Glass 的缩写，通过异方导电膜粘合，并在一定的温度、压力和时间下热压而实现液晶玻璃与柔性线路板机械连接和电气导通的一种加工方式。
COG	指	Chip On Glass 的缩写，通过异方导电膜粘合，并在一定的温度、压力和时间下热压而实现液晶玻璃与柔性线路板机械连接和电气导通的一种加工方式。

OGS	指	One Glass Solution 的缩写，单片玻璃解决方案，即在一片玻璃上同时实现保护玻璃和触摸传感器的双重作用。
In-Cell	指	内嵌式触摸控制技术的一种，将触控感测功能置于液晶面板之内。
On-Cell	指	内嵌式触摸控制技术的一种，将触控感测功能置于液晶面板的偏光片与彩色滤光片之间。
CCD	指	Charge-Coupled Device 的缩写，一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号。
压头	指	热压机用的压头（热压板）。一般内装加热芯，平整度要求高。热压机一般用于显示屏和电路板的机械电气连接。

本募集说明书若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 发行人基本情况

一、股权结构、控股股东及实际控制人情况

(一) 公司股权结构

截至 2020 年 3 月 31 日，公司股本结构情况如下：

股 东	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份	71,798,460	49.83%
1、国家持股		
2、国有法人持股		
3、其他内资持股	71,798,460	49.83%
其中：境内非国有法人持股		
境内自然人持股	71,798,460	49.83%
4、外资持股		
其中：境外法人持股		
境外自然人持股		
二、无限售条件股份	72,289,012	50.17%
1、人民币普通股	72,289,012	50.17%
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
三、股份总数	144,087,472	100.00%

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前十大股东及其持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例	限售股份 (股)
1	聂泉	境内自然人	88,066,722	61.12%	69,235,500
2	李艳阳	境内自然人	1,598,278	1.11%	-
3	刘文生	境内自然人	1,500,000	1.04%	1,125,000

4	饶忠华	境内自然人	1,321,300	0.92%	-
5	交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1,069,676	0.74%	-
6	钟辉	境内自然人	900,000	0.62%	675,000
7	信达证券股份有限公司	国有法人	540,000	0.37%	-
8	深圳市嘉源启航创业投资企业 (有限合伙)	其他	500,000	0.35%	-
9	中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	491,800	0.34%	-
10	上海于翼资产管理合伙企业 (有限公司)-东方点赞证券投资基金	其他	360,000	0.25%	-

(二) 控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人均为聂泉，中国国籍，未有任何其他国家和地区永久居留权，身份证号码为 43040219650129XXXX，住所为广东省深圳市宝安区大浪街道办。

聂泉，男，生于 1965 年 1 月，现任联得装备董事长、总经理，1987 年 9 月至 1989 年 6 月担任湖南叉车总厂产品设计工程师；1989 年 6 月至 1990 年 6 月广东东莞万宝至实业有限公司自动机室主管；1990 年 7 月至 1996 年 3 月任深圳沙井海洋电子有限公司工程部经理；1996 年 3 月至 1999 年 3 月任运科电子 (深圳) 有限公司厂长；2002 年 6 月至 2012 年 6 月担任联得有限执行董事、经理，2012 年 6 月至今担任联得装备董事长、总经理。

(三) 控股股东、实际控制人所持股份的权利限制及权属纠纷

截至 2020 年 3 月 31 日，控股股东、实际控制人聂泉持有公司 88,066,722 股股份，其中 69,235,500 股为有限售条件的股份，质押股份数量为 9,850,000 股。

聂泉先生所持股份质押属于正常融资行为。截至 2020 年 3 月 31 日，聂泉先生未质押股份合计 78,216,722 股，占其持有公司股本总额的比例为 88.82%，占发行人股本比例为 54.28%，远高于第二名股东所持股份 (1.11%)，且高于第 2-10 名股东持股份比例之和 (5.75%)。聂泉先生个人资信良好，筹资能力较强，

发行人不存在由于聂泉先生的股份质押行为导致控制权发生变更的风险。

除上述情况外，控股股东、实际控制人聂泉所持发行人股份不存在其他质押、冻结和其它限制权利的情况，亦不存在权属纠纷。

（四）控股股东、实际控制人投资的其他企业

截至 2020 年 3 月 31 日，发行人控股股东、实际控制人聂泉对外投资情况如下：

姓名	公司职务	被投资公司	持股比例	被投资公司与公司关系
聂泉	董事长、总经理	衡阳县四海矿业有限公司	30.00%	控股股东、实际控制人持股的公司

截至 2020 年 3 月 31 日，发行人控股股东、实际控制人聂泉不存在自营或为他人经营与发行人同类业务的情况，不存在与发行人利益发生冲突的对外投资。

（五）公司控股股东、实际控制人最近三年变化情况

最近三年，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

经核查，保荐机构认为，发行人控股股东、实际控制人具备作为发行人股东的主体资格；除上述质押情况外，控股股东、实际控制人目前所持发行人股份不存在质押、被司法机关冻结等导致其行使股东权利受到限制的情形，亦不存在任何法律纠纷。

二、所处行业的主要特点及行业竞争情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“制造业”中的“C35 专用设备制造业”。

（一）行业管理体制

公司所属行业的主管部门为工业和信息化部。工信部主要负责行业的管理、产业政策的制定、提出产业发展战略和规划等。

公司所属行业相关的自律性组织为中国电子专用设备工业协会和中国光学

光电子行业协会液晶分会。

中国电子专用设备工业协会成立于 1987 年，是由全国从事电子专用设备科研生产经营的企业公司、科研单位和大专院校自愿组成的行业性、非营利性的社会组织，是经中华人民共和国民政部批准登记注册取得社团法人资格的全国性工业行业协会。中国电子专用设备工业协会的宗旨是为会员、用户、政府做好服务，维护整个行业和会员的合法权益及经济利益，在政府和行业内的企事业单位之间发挥桥梁和纽带作用，推动我国电子专用设备行业的发展。

中国光学光电子行业协会液晶分会是隶属于中国光学光电子行业协会的二级协会。该分会是由全国从事液晶显示和其他平板显示以及上下游相关产业的企业、事业单位自愿组成的非盈利性社会团体，是跨地区、跨部门、跨所有制的行业组织。其宗旨和工作职责是“为液晶及平板显示行业的共同利益服务，加强政府和企业、企业与企业、企业与社会之间的沟通，维护会员单位的合法权益。团结全国行业同仁，推动和加速我国液晶及平板显示技术的不断提高，促进产业的发展”。

(二) 行业技术水平和技术特点、行业特征

平板显示器件及相关零组件生产设备是综合性的先进制造行业，具有技术集成度高、工艺要求高的特点，设备制造过程中涉及到半导体、电子、热学、自动控制学、机械设计学等多门学科，对设备制造厂商的技术整合能力提出了极高的要求。平板显示器件及相关零组件生产设备制造业发展时间较短，目前只在模组组装设备领域取得了较大的突破，而在面板生产设备等前期工序领域仍处于起步甚至空白状态。

虽然我国模组组装设备制造业已经取得了较大的突破，产品逐渐实现了国产化，但与日本、韩国、台湾这些先进国家和地区相比，仍存在一定的差距。首先，在零部件等配套产业方面我国仍有很大欠缺，生产设备中所需的一些关键零部件仍需要依赖于进口。其次，我国模组组装设备生产企业规模偏小、技术和工艺水平仍落后于国际先进企业，许多企业只能制造手动和半自动设备，能研发和制造全自动先进设备的优秀企业较少；而且国产设备的精度和稳定性仍与国际上的一流产品存在一定差距，尤其是在大尺寸显示产品生产设备领域，我国企业的生产

制造水平仍然不足。第三，我国企业的配套设施不够完善，大部分还处于传统机械加工的状况，部分小企业甚至一些基本配套设施都不完备。

就行业经营模式而言，平板显示器件及相关零组件生产设备种类繁多、工艺复杂、专业性强，产品需要按照客户的技术特点和设计要求进行量身定制，甚至有不少产品就是应客户的需求而进行开发和生产的，因此大部分企业都采用订单生产的形式，根据客户的订单定制和生产相应的产品。在销售方面，一般以直销为主，直接面向客户进行产品销售和相关技术服务。先进企业往往都会建立相对完善的销售和服务体系，为客户提供售前、售中到售后的全面技术支持和服务，企业的技术服务能力也是客户采购设备时考虑的重要因素之一。

（三）行业的区域性、季节性和周期性特征

1、区域性

目前我国平板显示产业形成了以深圳、广州为龙头的珠三角地区，以上海、南京、苏州、昆山为中心的长三角地区，以北京、天津、石家庄为主的环渤海区域，以及以武汉、长沙、成都为主体的中西部地区四个产业聚集区。这四个区域也是平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业的主要聚集区域。其中，珠三角是我国电子信息产业最发达的地区，该区域具有“中小企业多、本土企业多”的特点，拥有大量的平板显示相关的企业，产业配套水平相对比较完整，为平板显示器件及相关零组件生产设备企业的发展提供了良好的产业基础。

2、季节性

平板显示器件及相关零组件生产设备的最终用户是平板显示产品生产企业，这些用户的设备采购一般遵循严格的预算管理制度，投资立项申请与审批集中在每年的第四季度，次年的上半年执行实施相对集中，年底前完成设备验收。与此相应，公司的销售订单在上半年明显增加，产品的销售收入的确认主要集中在下半年尤其是第四季度，因此上半年收入相对较小。

3、周期性

平板显示器件和相关零组件的终端应用领域是电脑、手机、家电等电子产品，这些产品的市场需求和销售情况在一定程度上会受宏观经济环境的影响，

平板显示器件生产线的投资也会受宏观经济的变化而波动，因此平板显示器件及相关零组件生产设备制造业的市场需求也会受宏观经济的影响。但平板显示产业制造工艺和技术一直处于不断创新和发展变化的过程中，平板显示器件及相关零组件生产设备制造业也将不断地创新和发展。尤其是我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造业目前仍处于发展初步阶段，未来随着我国平板显示产业市场环境和技术水平的进步，我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造业有望得到快速发展。

我国平板显示产业 2009 年以来进入快速发展阶段，成为全球平板显示产业的布局中心。近两年，在其他国家平板显示产业投资相对停滞的情况下，我国的平板显示产业仍保持了良好的增长，未来一段时间，我国平板显示产业仍有望保持稳健发展的趋势，为我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造业的持续发展提供良好的基础。

（四）公司所处行业与上下游行业的关联性

平板显示器件及相关零组件生产设备的上游原材料主要包括冷、热轧板、不锈钢板等金属材料和电动、气动、光学等机械、电气零部件和配件，分别属于金属延压加工业和通用设备制造业。下游直接客户为平板显示产品生产企业，终端用于电脑、家电、通信设备等电子产品。

1、上游行业的发展状况对本行业的影响

平板显示器件及相关零组件生产设备的上游材料包括金属延压产品和机械零部件。在金属延压产品方面，我国金属延压加工业发展比较成熟，产业处于良好发展阶段，市场供应充足，能够满足平板显示器件及零组件生产设备制造业的发展需求。

在机械和电气零部件方面，平板显示器件及零组件生产设备所需的零部件属于精密部件，在精度、稳定性等方面具有很高的要求。目前我国精密部件的制造水平仍相对不足，虽然国内企业也能提供平板显示器件及相关零组件生产设备所需的各种机械、电气零部件，但对于一些关键零部件国内产品难以满足平板显示器件及相关零组件生产设备的质量要求。因此部分关键零部件仍依赖

于进口。由于国际供应链中机械和电气零部件的可选品牌较多，没有对我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造业的发展形成较大制约，但未来我国仍需要进一步提升机械、电气零部件领域的整体制造水平才能为我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造业的全面发展创造更好的产业配套条件。

2、下游行业的发展状况对本行业的影响

下游行业对平板显示器件及相关零组件生产设备行业的影响主要体现在两个方面：第一，下游市场需求的持续增长不断扩大平板显示器件及相关零组件生产设备行业的发展空间；第二，平板显示产业工艺技术的不断革新将导致平板显示器件及相关零组件生产设备规格、类型及功能的不断变化。

随着全球电子产业的快速发展，平板显示器件的主要应用领域，如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、平板电视等，市场规模都在持续增长，为平板显示产业创造良好市场需求。根据国际调研机构 Displaysearch 的统计，2009 年-2017 年，全球平板显示行业收入从 921.12 亿美元增长至 1,100 亿美元。我国是世界电子产品的制造中心，在全球平板显示产业逐渐向我国转移的市场环境下，全球电子整机产品和平板显示产品市场规模的增长将给我国平板显示器件及相关零组件生产设备行业的发展形成巨大的带动作用。

（五）行业竞争情况

1、行业竞争格局和市场化程度

我国的平板显示器件及相关零组件生产设备制造业发展相对较晚，目前仅在模组组装设备领域实现了较大的突破，而在显示面板生产设备领域还非常薄弱，我国显示面板生产阶段所需的重要设备基本依赖于进口。目前我国在模组组装设备领域企业数量较多，市场集中度不高，参与市场竞争的包括许多本土企业和部分国际企业。

平板显示产业对设备供应商的售后服务和技术支持有较高的要求，随着我国平板显示产业的发展，一些国际先进的设备供应商逐渐进入大陆市场，开拓大陆的平板显示器件及相关零组件生产设备市场，比如日本的 TEL、芝浦、松下，台湾的旭东机械、易发精机等都在大陆建立了分支机构或生产基地。由国际先进企

业投资建立的外资企业可以依托母公司技术能力，往往具备很强的技术实力和比较全面的产品线，不仅能生产显示模组组装设备，还能生产显示面板生产设备等前道工序所需的生产设备。

近年来，随着我国装备制造业技术水平的发展，我国本土的装备制造企业也在显示模组组装设备领域实现了重大的突破性发展，涌现出一批优秀的企业，比如联得装备、正业科技、智云股份等，部分显示模组组装设备制造水平已经接近国际先进企业，现在国产设备的质量性能已经完全可以满足模组生产工序的需求，本土企业的崛起和发展逐渐打破了国外设备在我国模组组装设备领域的垄断。

与外资企业相比，本土企业在整体技术能力上仍存在一些差距，但产品具有更好的性价比。而且本土企业在售后服务和技术支持方面具有显著的本土化服务优势，可以与客户之间实现比较便利的技术交流及合作，提供全面的售后服务和技术支持。因此，国产设备在与国外设备的竞争中也占据一定的相对优势。现在，我国模组组装设备市场中，国产设备的市场份额正在不断提高。

从市场发展情况来看，国产模组组装设备的市场竞争力和市场地位未来有望继续提升。一方面，在国家产业政策的支持下，我国本土企业的研发能力和制造水平正在不断提高；其次，随着平板显示行业的发展，我国国产设备在运输成本、售后服务方面的本土化优势更加明显；第三，由于金融危机、欧债危机等因素的影响，近几年全球经济形势比较严峻，给国内外企业带来了较大的成本和生存压力，国产设备良好的性价比优势赢得了越来越多的平板显示生产企业的青睐。因此，未来我国模组组装设备的国产化进程将会进一步深入发展。

2、行业内的主要企业

(1) 主要国际企业

1) 东京电子株式会社

日本 TEL 成立于 1963 年，是全球领先的半导体制造设备、液晶显示器制造设备制造商之一。其产品主要包括：涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、湿法清洗设备、测试设备及平板液晶显示设备等。日本 TEL

在日本、美国、欧洲、台湾、韩国及中国等地都建立了子公司或分支机构。

日本 TEL 于 2002 年 4 月在中国上海设立了分公司，成为最早进入中国市场的半导体制造和平板液晶显示设备供应商之一。

2) 日本东丽

日本东丽工程株式会社成立于 1960 年，原名为东洋工事株式会社。该公司是一家综合性的工程及自动化生产设备制造，可以在包括半导体、FPD、二次电池/太阳能电池的制造、检查装置在内的广泛领域内提供解决方案。其主营业务分为“工程事业”和“电子事业”两大部分，其中电子事业领域的主要产品包括：液晶及半导体相关贴片机、真空印刷封装、曝光机等高精度微细加工装置，FPD/太阳能电池基板涂布装置（东丽狭缝喷嘴涂布机），液晶/半导体/太阳能电池用、外观/异物/膜厚/色差/表面形状/应力等的检查设备、ID 打码机等。2002 年东丽在中国成立上海华丽咨询有限公司从事产品的销售和技术服务。

3) 日本芝浦

日本芝浦科技株式会社的前身为东京芝浦电气株式会社（即现在的东芝集团）的汽车事业部门，该部门于 1939 年分离成立 Shibaura Kyomachi Seisakusyo，经过多次变革之后形成现在的日本芝浦科技株式会社。2001 年芝浦在中国成立芝浦机电（上海）有限公司。目前芝浦经营的主要产品包括 FPD 制造设备（剥离设备/洗净设备/显影设备/喷墨设备/ODF/高速贴片涂布设备/检测设备）、半导体制造设备（干法蚀刻设备/灰化/单片）、OLB/PCB（用于液晶生产线/用于太阳能发电）、倒装贴片设备、真空设备（贴合设备/用于 BD 生产线的设备）、激光应用设备等。

4) 旭东机械工业股份有限公司

旭东机械工业股份有限公司成立于 1979 年，从事自动化专用机械设计加工和制造，1993 年在江苏昆山设立了旭东机械（昆山）有限公司。2001 年，旭东机械成立电子设备事业部，进入电子专用生产设备制造领域，其电子设备事业部于 2002 年开始从事液晶显示（LCD/LCM）自动涂胶设备和模组组装设备的研发。目前旭东机械电子设备事业部主要产品包括：点胶/涂胶专用设备、各式

LED 封装、半导体封装设备、超声波芯片倒装(Flip-Chip)设备、TFT-LCD 制程设备等。

5) 易发精机

易发精机股份有限公司下设易发精机（成立于 1988 年）和东野精机（成立于 1993 年）两个公司。其中易发精机主要从事工业设备的研发和制造，业务领域涉及 LCD 产业、半导体产业、触摸屏产业、DISK 产业、储能设备产业等；东野精机主要从事设备组件的研发和制造，产品包括铝材组件系列、一般配件系列、共用配件系列、封板组件系列等。2002 年易发精机在上海设立易发精机（上海）有限公司，2010 年东野精机在昆山设立东野精机（昆山）有限公司。

(2) 主要国内企业

国内从事平板显示器件及相关零组件生产设备制造的上市公司主要是联得装备、正业科技和智云股份。

1) 正业科技

正业科技成立于 1997 年 11 月，是一家专业从事精密仪器设备及高端电子材料的集研发、生产、销售和技术服务于一体的国家火炬计划重点高新技术企业。2016 年，正业科技收购集银科技 100% 股权。集银科技成立于 2002 年，是一家专业从事液晶模组自动化组装及检测设备的研发、设计、生产、销售及服务的的高新技术企业，其合作的客户包括欧姆龙、JDI、夏普、天马等国内外众多知名厂商。

2) 智云股份

智云股份成立于 1999 年 6 月，是国内主要成套自动化装备的方案解决商之一。2015 年智云股份收购鑫三力 100% 股权。鑫三力是一家专业从事平板显示模组自动化组装及检测设备的研发、设计、生产、销售及服务的的高新技术企业，产品广泛应用于平板显示模组的组装生产过程中。

3) 易天股份

易天股份成立于 2007 年 2 月 14 日，是一家国内电子专用设备供应商，基

于精准对位、精准贴附技术，致力于为客户提供专业化、高性能的国产化电子专用设备。目前主要产品为平板显示器件生产设备，可广泛应用于平板显示器件中显示模组的组装生产，并向半导体微组装设备等领域拓展。

三、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司经营范围

发行人的经营范围为：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，口罩机的研发、生产与销售、调试安装及售后服务；设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口；劳保（口罩、防护服、手套）的生产与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；许可经营项目：普通货运（不含危险货物运输及凭道路运输经营许可证经营）。

（二）发行人主营业务概览

公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。

公司目前产品主要为平板显示模组组装设备，可广泛应用于平板显示器件中显示模组以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程中，借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件，是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。

经过多年发展和积累，公司已经成为国内平板显示行业前端领域少数几家具备全自动模组组装设备研发和制造能力的公司之一，涵盖平板显示模组组装生产阶段的各项关键程序，为平板显示行业模组组装提供定制化、一站式配套设备、技术的供应和服务。

公司的主营业务、主要产品和服务以及主要经营模式自成立以来未发生重

大变化。

（三）发行人主要产品

公司目前主要产品为平板显示模组组装设备，包括邦定设备及贴合设备。公司所产设备可广泛应用于平板显示器件中显示模组，主要是 TFT-LCD 显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程。

1、热压类设备



TFOG 连线机系列设备

TFOG 连线机系列设备整合了 Panel CCD 自动校正，ACF 贴附及检测、FPC 自动上料对位预压、FPC 本压等工艺，广泛应用于平板显示器和触摸屏的生产中，尤其针对当前主流内嵌式触控技术 In-Cell、On-Cell 产品及外挂式 OGS 触控产品，同时兼顾一般的 TP、LCD 等产品的 FPC 自动热压邦定工艺，采用高科技智能化技术，导入直线电机搬运技术和 CCD 自动对位、检测、校正技术，全方位提高设备的自动化程度、精度、效率和稳定性，具有自动化程度高、精度高、效率快、系统稳定等优点。



全自动 COG 系列设备

全自动 COG 系列设备主要用于显示模组加工工艺过程中, 实现将芯片自动邦定在玻璃上, 具有组装精度高、效率快、品质稳定、节省人力物力等优点。



全自动 FOG 系列设备

全自动 FOG 系列设备整合了 ACF 贴附、FPC 预压、FPC 本压等工艺, 广泛应用于平板显示器和触摸屏的生产中, 可应对触摸屏 Film、OGS、DITO、SITO 等各种类型产品的 FPC 邦定工艺, 具有自动化程度高、效率快、系统稳定等优点。



ACF 粘贴机系列设备

ACF 粘贴机系列设备主要用于触控和显示模组加工工艺过程中，实现将 ACF 贴附在玻璃或 Film 上。有多种类型产品可供选择，包括单压头多段贴附、旋转式单压头双工位贴附、全自动 ACF 贴附等系列。



FPC 邦定机系列设备

FPC 邦定机系列设备主要用于在触控和显示模组加工工艺过程中，实现将柔性线路板 FPC 邦定在玻璃或薄膜上，有左右移动式双压头、前后移动式双压

头、带预压功能的多段贴合等类型可供选择。

2、贴合类设备



OCA 全自动全贴合机

OCA 全自动全贴合机应对当前主流全贴合技术，同时整合 OCA 贴合工艺中的软对硬贴合和硬对硬贴合功能，在结构和工艺上全面革新升级，实现 OCA 自动上料，自动撕轻/重离型膜，自动对位，自动软对硬贴合/自动硬对硬贴合等多个工艺，应用于 TP 与 LCM（或 LCD）、Cover Glass 与 Sensor Glass 等以 OCA 为贴合介质的全贴合。结合智能化控制系统，充分发挥设备的潜能，成熟运用自动撕膜技术、CCD 自动对位技术、真空贴合技术、自动搬运技术等，使设备具有自动化程度高、贴合精度、效率快、良率高等特点。



玻璃对玻璃贴合机系列设备

玻璃对玻璃贴合机系列设备适用于触摸屏盖板与功能面板之间的贴合以及触控模组与液晶显示模组之间的贴合。设备采用先进的 CCD 自动对位系统，图像处理系统，结合高真空度贴合环境，具有贴合精度高、无气泡、品质稳定等优点。



薄膜对玻璃贴合机系列设备

薄膜对玻璃贴合机系列设备可将 OCA（或偏光片、Film 膜等）贴附在玻璃上。设备采用了多项公司自行研发出的专利技术以及 CCD 自动对位系统，具有贴合精度高，品质稳定的特点。



软膜贴合机系列设备

软膜贴合机系列设备主要应用于两片软膜（或软膜与硬基板）之间的贴合，主要是将 OCA（或偏光片、Film 膜等）贴附在 PET 或玻璃上。设备采用 CCD 影像对位系统，具有对位精度高、效率快等的优点。



全自动偏光片贴附机系列设备

全自动偏光片贴附机系列设备主要用于液晶显示器（LCD）的偏光片贴附工艺中，具有效率高、自动化程度高、节省人力、系统稳定等优点。

3、AOI 检测设备



AOI 检测设备

AOI 检测设备通过光学成像的方法获得被测对象的图像，经过特定算法处理及分析，与标准模板图像进行比较，获得被检测对象缺陷。

4、其他设备



全自动背光叠片机系列设备

全自动背光叠片机系列设备用于背光模组中各种片材的组装、叠加，采用了公司自主研发的专利技术，具有效率高、自动化程度高、精度高、系统稳定等优点，能够有效节省人力，提高产品品质和效率。



全自动背光-模组组装机系列设备

全自动背光-模组组装机系列设备主要用于 LCD 面板与 BLU（背光模组）的精密组装贴合。设备采用公司自主研发的专利技术以及 CCD 自动对位系统，具有组装精度高、效率快、品质稳定、节省人力物力等优点。



覆膜机系列设备

覆膜机系列设备主要用于在玻璃表面覆上（如 LENS）贴附保护膜材料。

采用步进电机驱动送料、光纤感应定位、角度调节、XY 校正、LENS 直角边定位、真空吸附、胶轮滚轧贴，在贴附处全程有离子风，保证产品位置精度高且稳定，表面无气泡。



精雕机系列设备

精雕机系列设备主要用于玻璃、PET 等材料的切割、仿形、钻孔、磨边等精密加工工艺中。目前拥有双头、单头以及带 CCD 对位系统的精雕机设备。

四、现有业务发展安排及未来发展战略

公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。公司目前产品主要为平板显示模组组装设备，可广泛应用于平板显示器件中显示模组以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程中，借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件，是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。

公司业务发展计划如下：

（一）公司将利用现有的技术和开发平台，积极开发电子专用设备其他领域的新产品和新技术，发挥公司已有的客户和品牌优势，充分利用公司在日本设立的研发机构，大力发展其他电子专用设备业务，如半导体行业专用设备业务；

(二) 进一步加大人才的培养和引进力度, 公司主要从事平板显示器件及相关零组件生产设备制造, 所处行业为典型的技术密集型行业。公司自成立以来一直关注技术、管理、市场营销人才的内部培养和外部引进, 从而能在高效管理下开发契合市场需求的技术和产品并迅速实现工业化生产和销售。公司核心竞争优势的取得在很大程度上依赖于优秀的技术、管理和销售团队。公司拟在未来通过内部培养和外部引进相结合的方式, 加大人才队伍储备和建设力度;

(三) 完善市场营销和服务网络, 公司将充分利用广泛的市场营销和服务网络, 进一步扩大市场影响力, 加大对优质客户的配合和支持力度; 同时扩展公司产品的市场应用领域, 在平板显示模组组装领域之外扩展新应用领域, 扩展现有优势产品的应用范围。同时, 在稳定国内市场领先优势及市场份额的前提下, 积极开拓海外市场的销售和寻求新的市场份额;

(四) 健全和完善公司内部控制体系, 完善公司治理结构, 加强公司信息化系统的建设, 从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管, 统一管理, 通过透明化管理来提高企业综合管理水平, 控制企业决策风险, 提升企业运行效率和管理水平。

五、公司财务性投资情况

本次发行董事会决议日前六个月至今, 公司不存在实施或拟实施的财务性投资; 最近一期末, 公司不存在持有金额较大的财务性投资或类金融业务的情形。具体如下:

(一) 财务性投资范围

根据 2020 年 6 月证监会发布的《再融资业务若干问题解答》, 财务性投资范围如下:

财务性投资的类型包括但不限于: 类金融; 投资产业基金、并购基金; 拆借资金; 委托贷款; 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资; 购买收益波动大且风险较高的金融产品; 非金融企业投资金融业务等。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资, 以收购或

整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

(二) 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资

2020年4月28日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的事项。自该次董事会决议日前六个月起（即2019年10月28日）至本募集说明书签署日期间，公司不存在新设立或投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款，以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资，购买收益波动大且风险较高的金融产品，非金融企业投资金融业务，融资租赁，商业保理和小贷业务等财务性投资，亦无拟实施上述投资的计划。

综上所述，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资情况。

(三) 最近一期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形

截至2020年6月30日，公司不存持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财。

截至2020年6月30日，公司长期股权投资情况如下：

被投资单位	账面价值 (万元)	持股比例	投资时间	主营业务	是否为财务 性投资
华洋精机股份有限公司	1,328.36	40.00%	2018年8月	生产工业视觉检测、视觉测量全系列设备	否

华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）为一家位于台湾台南市的企业，主要从事工业视觉检测及视觉测量全系列设备生产业务。华洋公司与发行人同处平板显示设备领域，与发行人业务具有较强的互补性和衔接性，不属于财务性投资。

综上所述，发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

第三节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次非公开发行股票的背景

1、下游行业发展迅速，为相关智能装备制造企业带来机遇

公司本次非公开发行股票募集资金并在东莞地区建设生产基地，在发行人现有产品的基础上进一步新增汽车电子显示、大尺寸智能电视、半导体封测等应用领域，进一步优化公司的产品结构、增加新的利润增长点并进一步增强公司的盈利能力。

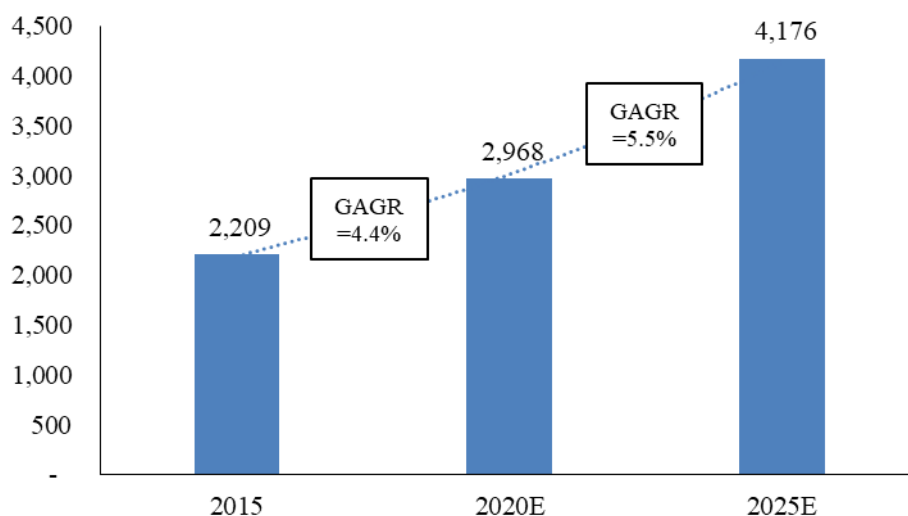
上述应用领域具有良好的发展前景和广阔的市场空间，具体情况如下：

（1）汽车电子显示领域

在智能化、网联化及电子化的浪潮下，汽车已经从传统的机械产品发展为电子信息系统控制的智能产品。随着用户对汽车尾气排放、安全性、舒适性、娱乐性的需求不断提高，以及自动驾驶系统、信息娱乐与网联系统部件的不断应用，汽车电子化已成为未来汽车工业发展的一大趋势。

2015年，全球汽车电子市场规模为2,209亿美元。2020年，该市场规模预计达到2,968亿美元，并以5.5%的年均复合增长率在2025年预计增长至4,176亿美元。

2015年至2025年全球汽车电子市场规模（亿美元）

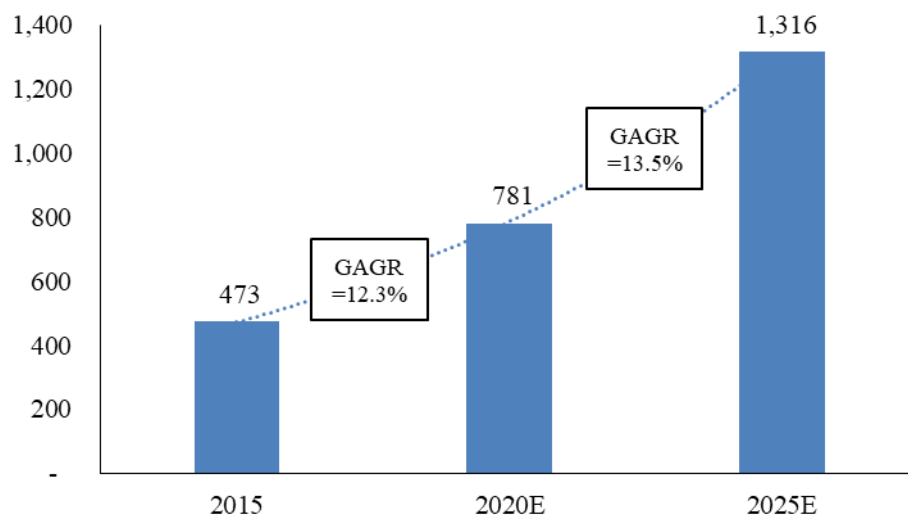


数据来源：HIS、Strategy Analytics、中金公司研究报告

根据国务院发展研究中心发布的《中国汽车产业发展报告》，目前中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为 10%，轿车电子产品成本比重已达 10%~25%，世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达 35%，未来国内汽车电子成本占总整车成本比例将有所提升，为汽车电子产业带来巨大的增量空间。

2015 年，国内汽车电子市场规模为 473 亿美元。2020 年，该市场规模预计达到 781 亿美元，并以 13.5% 的年均复合增长率在 2025 年预计增长至 1,316 亿美元。

2015年至2025年国内汽车电子市场规模（亿美元）



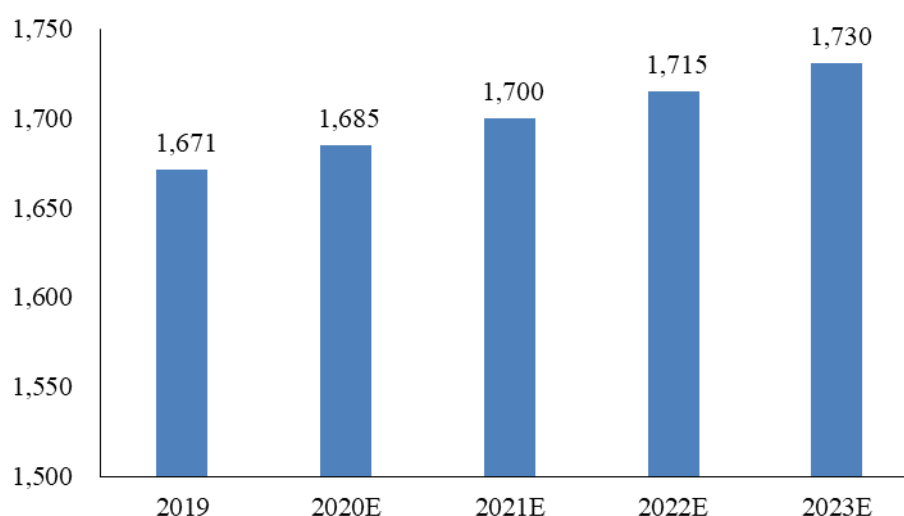
数据来源：HIS、Strategy Analytics、中金公司研究报告

(2) 大尺寸平板显示领域

随着移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术的不断成熟及迅猛发展，智能电视逐渐成为家庭重要的视听、娱乐和信息分享交互智能终端，市场需求持续增长，销售量不断攀升。根据 Strategy Analytics 数据，2018 年智能电视全球销量达到 1.57 亿台，占全年电视总销量的 67%。

根据 Statista 数据，2019 年包括智能电视在内的全球电视行业市场规模为 1,671 亿美元，该市场规模预计在 2020 年达到 1,685 亿美元。

2019 年至 2023 年全球电视行业市场规模（亿美元）

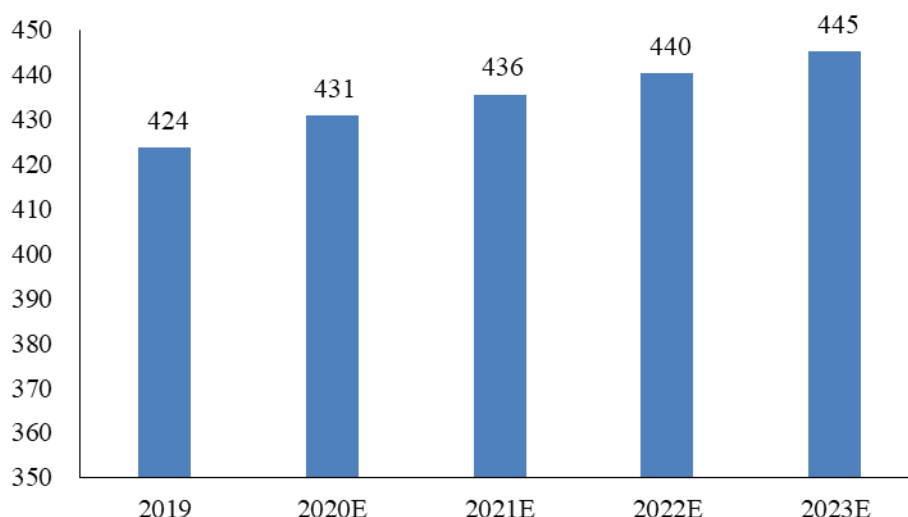


数据来源：Statista

与此同时，我国智能电视行业也在快速发展，主要传统电视厂商及华为、小米、OPPO、PPTV 等互联网企业均推出了智能电视品牌及产品。根据前瞻产业研究院数据，2014 年-2018 年，我国智能电视市场销量由 2,931 万台增长至 4,249 万台，复合增长率 9.37%，呈快速增长态势。

根据 Statista 数据，2019 年包括智能电视在内的国内电视行业市场规模为 424 亿美元，该市场规模预计在 2020 年预计达到 431 亿美元。

2019 年至 2023 年国内电视行业市场规模（亿美元）



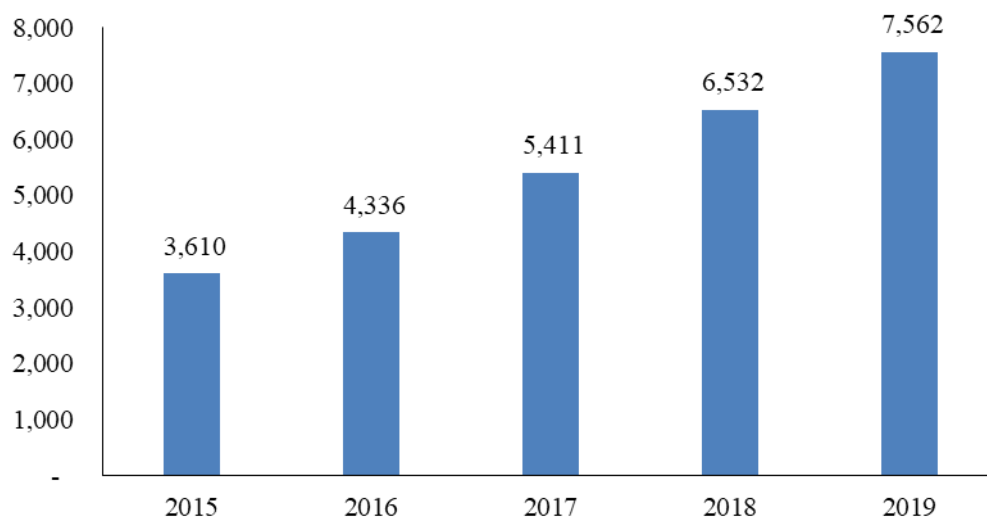
数据来源：Statista

(3) 半导体封测领域

半导体行业是电子信息产业的基础，半导体和其他元器件通过集成电路板连接，应用于个人电脑、智能手机、汽车电子等终端产品、承担信息的载体和传输功能，是信息化社会的重要基石之一。

根据世界半导体贸易统计组织 WSTS 统计，2019 年全球半导体产业市场规模为 4,121 亿美元，预计在 2020 年将增长至 4,330 亿美元，行业景气度良好，市场空间巨大。我国是全球半导体市场规模增速最快的国家之一。根据中国半导体行业协会统计，2018 年和 2019 年，我国半导体产业市场规模分别为 6,532 亿元和 7,562 亿元，同比增长率分别为 20.7% 和 15.8%，显著高于全球半导体产业市场增速。

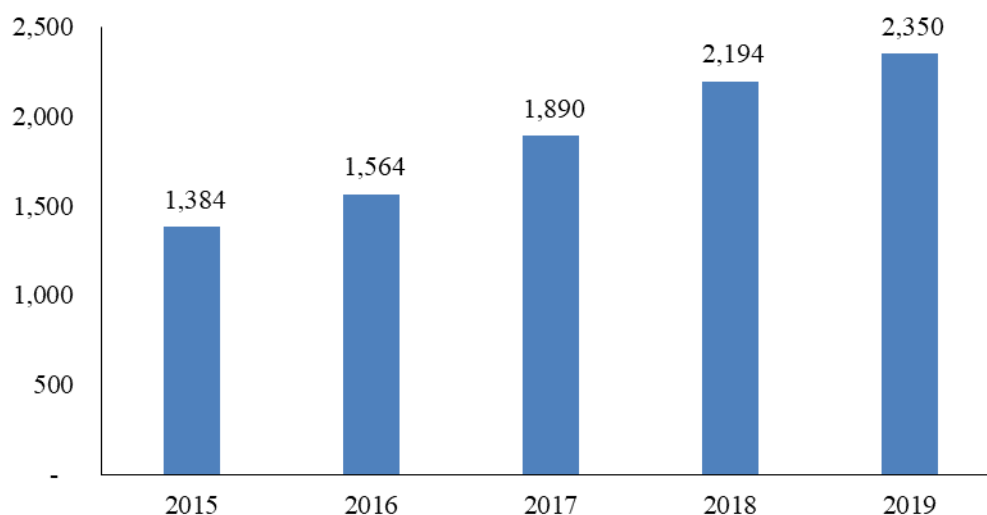
2015年至2019年国内半导体产业市场规模（亿元）



数据来源：中国半导体行业协会

半导体产业主要包括芯片设计、芯片制造和封装测试三个部分。其中封装主要为保护芯片免受物理、化学等环境因素的伤害，增强芯片散热性能，实现电气连接并确保电路正常工作；测试主要为对芯片的功能、性能进行测试。我国半导体封测产业保持快速增长，根据中国半导体行业协会统计，2019年我国半导体封测产业规模为 2,350 亿元，占整体产业规模的 31%。2015 年至 2019 年，我国半导体封测产业规模复合增长率为 14.15%。

2015年至2019年国内半导体封测产业市场规模（亿元）



数据来源：中国半导体行业协会

同时伴随全球众多晶圆厂项目的投入建设，大批新建晶圆厂产能的释放也

将带来更多的半导体封测新增需求，推动半导体封测产业继续增长。

半导体产业作为信息产业的核心和基础，受到国家政策的大力支持，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》、《集成电路产业“十三五”发展规划》和《中国制造 2025》等相关政策的稳步推进，半导体产业及封测子产业有望迎来新的发展机遇。

目前全球及国内在汽车电子显示、大尺寸平板显示、半导体封测领域发展前景良好，为本次募投项目新增产品销售及产能消化提供了良好的市场保障。

2、项目建设符合国家相关政策规划的要求

发行人本次募集资金投资项目建设，符合国家相关政策规划的要求，项目建设和实施具有良好的政策基础和环境，具体情况如下：

(1) 汽车电子显示领域

目前，汽车已发展为电子信息系统控制的智能产品，作为汽车向高安全性、高环保型发展的重要环节，汽车电子行业已成为汽车工业的重要组成部分和基础。

2017 年以来，国家层面的汽车电子政策密集出台，对汽车电子行业提出了具体的战略部署和行动计划。2017 年，工业和信息化部出台《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》，其中智能网联汽车规模化应用是行动计划的首要目标之一；2017 年，工业和信息化部、国家发改委、科技部出台《汽车产业中长期发展规划》，指出要突破先进汽车电子等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商；2018 年，工业和信息化部出台《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，明确以网络通信技术、电子信息技术和汽车制造技术融合发展为主线，充分发挥我国网络通信产业的技术优势、电子信息产业的市场优势和汽车产业的规模优势；2019 年，国家发改委出台《汽车产业投资管理规定》，着力构建智能汽车创新发展体系，聚焦汽车产业发展重点；2020 年，国家发改委等部门出台《智能汽车创新发展战略》，将着力推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。

（2）平板显示领域

平板显示生产设备制造业是智能装备制造业的重要分支，平板显示生产装备制造业的发展进步对我国平板显示产业乃至电子信息产品制造业整体水平的发展和提升有着重要的意义。

在 2006 年国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中，就将“新型显示器件生产设备”列入需要重点突破的关键领域。2010 年以来，国家政府又制定了大量的产业政策引导和支持我国平板显示生产设备制造业的发展。比如 2010 年发布的《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，2011 年发布的《产业结构调整指导目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《工业转型升级规划（2011-2015 年）》，2012 年发布的《重大技术装备自主创新指导目录》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等，2015 年发布的《中国制造 2025》，2016 年发布的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》。此外，2011 年修订的《鼓励进口技术和产品目录（2011 年版）》和 2012 年修订的《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》还分别将平板显示生产设备及制造技术列入“鼓励引进的先进技术”和“免征进口关税和进口环节增值税”目录中，鼓励我国引进平板显示生产设备相关技术和产品。

（3）半导体行业

半导体行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展和产业升级上具备战略性作用。

近年来，国家不断出台政策支持半导体产业发展。2012 年，工信部出台了《集成电路产业“十二五”发展规划》，规划的发展目标为到“十二五”末，产业规模再翻一番以上；2014 年，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》，指出到 2020 年，集成电路全行业销售收入年均增速超过 20%，并设立国家产业投资基金；2015 年，国务院出台《中国制造 2025》，将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域；2016 年，国务院出台《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，将提升封

装测试业技术水平和产业集中度,加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域;2019年,财政部、国家税务总局出台《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》,为符合条件的集成电路企业提供税收优惠。

此外,广东地方政府也出台了相关的产业政策,如《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)》、《广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》、深府〔2014〕96号《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划(2014—2020年)》、深府〔2014〕97号《深圳市人民政府关于印发机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展政策的通知》,为智能装备企业提供政策支持。

本项目的建设可以极大地提高企业在智能装备方面的生产能力、推动我国智能装备产业的发展,符合国家相关产业的扶持政策。

(二) 本次非公开发行的目的

1、优化产品结构和业务布局,拓展新的利润增长点

公司产品主要为平板显示器件及相关零组件生产设备,主要下游客户为国内外平板显示领域的知名企业,该类客户产品主要应用于智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子产品。本次非公开发行募集资金投资项目顺利建成达产后,有助于进一步优化公司的产品结构、增加新的利润增长点并进一步增强公司的盈利能力,为公司经营业绩增长提供新的动力,降低单个领域市场变动对公司整体业绩的影响,提高公司抗风险能力及综合竞争实力。

2、优化资本结构,为公司后续发展经营提供资金保障

近年来,公司主营业务规模持续扩大、营业收入增长持续增长,对公司营运资金提出了更高的要求,对流动资金的需求较大。同时,公司不断加大研发投入、提升自主创新能力,并积极引进优秀的管理、技术人才,也产生了较大的资金需求。公司拟将本次非公开发行股票中的24,000.00万元用于补充流动资金,将为公司未来日常经营发展、研究开发等提供有力的资金保障,缓解公司营运资金压力、改善资产结构,进一步降低经营风险和财务风险,进一步提升盈利水平。

二、发行对象及与发行人的关系

（一）发行对象基本情况

本次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人聂泉先生在内的不超过 35 名特定对象。

聂泉拟以现金认购公司本次向特定对象发行的股票,认购总额不低于 1,500 万元(含本数)且不超过 3,000 万元(含本数),认购金额的具体区间为 1,500 万元至 3,000 万元,最终认购股票数量根据实际认购金额除以发行价格确定。

1、基本信息

聂泉,中国国籍,未有任何其他国家和地区永久居留权,身份证号码为 43040219650129XXXX,住所为广东省深圳市宝安区大浪街道。

2、最近三年主要任职情况

聂泉先生最近三年一直担任公司董事长、总经理职务;目前聂泉先生担任苏州联鹏的执行董事及经理、衡阳联得的执行董事及经理、东莞联鹏的执行董事及经理、衡阳县四海矿业有限公司监事。

3、本募集说明书披露前 12 个月内与公司之间的重大交易情况

本次募集说明书披露前 12 个月内,公司与聂泉先生及其控制公司之间存在如下关联交易:

为支持公司发展,发行人控股股东、实际控制人聂泉为公司提供了担保,具体情况如下:

单位:万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
聂泉	8,000.00	2018 年 7 月 6 日	2019 年 7 月 6 日
聂泉	10,000.00	2018 年 7 月 31 日	2019 年 7 月 30 日
聂泉	6,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日
聂泉	10,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 27 日
聂泉	8,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日
聂泉、唐湘晖	12,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 14 日

聂泉	10,000.00	2019年2月21日	2020年2月20日
聂泉	10,000.00	2019年3月22日	2020年3月6日
聂泉	10,000.00	2019年8月1日	2020年8月1日
聂泉	6,000.00	2019年12月17日	2020年12月17日

除此以外，聂泉先生与公司之间不存在其他重大交易情况。

（二）附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容

2020年4月28日，公司与聂泉先生签署了《附条件生效的认购协议》。2020年6月19日，公司与聂泉先生签署了《认购协议补充协议》。2020年8月7日，公司与聂泉先生签署了《认购协议补充协议（二）》协议主要内容如下：

1、认购主体

甲方（发行人）：深圳市联得自动化装备股份有限公司

乙方（认购人）：聂泉

2、协议标的

甲方以非公开发行方式，向包括乙方在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象发行股票募集资金。本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

3、认购数量及调整

甲方拟以非公开方式向特定对象发行不超过本次发行前甲方总股本30%的股票（具体以监管部门最终审核及注册数量为准）。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。其中，乙方同意以现金方式认购本次非公开发行股票，认购总额不低于1,500万元（含本数）且不超过3,000万元（含本数），认购金额的具体区间为1,500万元至3,000万元，最终认购股票数量根据实际认购金额除以发行价格确定。

如甲方股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

4、认购方式、认购价格和认购款项支付

1) 认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股票。

2) 认购价格

2.1 本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，甲方本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日联得装备股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

2.2 本次非公开发行股票采取询价发行方式，甲方本次非公开发行股票的具体发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。乙方不参与本次非公开发行股票的询价，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次非公开发行股票未能通过上述规定的询价方式产生发行价格，则乙方不参与本次认购。

2.3 发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

3) 认购款的支付方式

在发行人本次非公开发行取得中国证监会注册文件后，发行人聘请的主承销商将根据中国证监会注册文件确定的本次非公开发行股份的发行方案向认购方发出认购股款缴纳通知书，乙方应当按照缴纳通知书的规定，以现金方式一次性将股份认购价款缴付至主承销商为甲方本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

如果乙方预计无法在缴款期限内足额缴付认购价款的，应立即通知发行人及主承销商。乙方未能在缴款期限内足额缴付认购价款的，发行人有权在乙方足额缴付认购价款前，书面通知取消乙方认购本次非公开发行 A 股股票的资格。

5、股票交割

乙方缴付全部股票认购价款之日起 10 个工作日内，甲方应聘请有资质的验资机构进行验资。在验资机构就本次发行出具《验资报告》之日起 30 个工作日内，发行人应向证券登记结算机构申请办理将标的股票登记于乙方 A 股证券账户的相关登记手续，并采取必要措施及最大合理努力，尽快完成上述股票登记手续，以使乙方成为认购股票的合法持有人。

6、股份锁定

乙方本次认购的甲方股份，自甲方本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；法律法规对限售期另有规定的，依其规定。若前述限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整。

本次非公开发行结束后，乙方所认购的甲方非公开发行的股票因甲方分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安排。

限售期结束后，乙方将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于乙方所认购股票锁定期另有要求的，从其规定。

7、协议生效

1) 本协议为附条件生效的协议，须在甲、乙双方签署且以下先决条件全部满足之日起生效：

- 1.1 公司董事会批准本次非公开发行股票及协议；
- 1.2 公司股东大会批准本次非公开发行股票及协议；
- 1.3 本次非公开发行股票通过监管部门审核及注册后。

2) 若上述约定的协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效且不能得以履行的，甲、乙双方互不追究对方的法律责任。

8、违约责任

1) 协议任何一方对因其违反本协议或其项下的任何声明、承诺或保证而使对方承担或遭受任何经济损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。

2) 若乙方未按本协议约定如期足额履行缴付认购资金的义务，则构成对本协议的根本违约，乙方需向甲方支付违约金，违约金金额=(乙方承诺认购股份资金总额-乙方实际缴纳认购资金金额)*1%。

3) 本协议项下约定之本次发行事项如未获得：3.1 发行人董事会审议通过；3.2 发行人股东大会审议通过；3.3 本次非公开发行股票通过监管部门审核及注册，均不构成甲方违约，甲方无需承担违约责任。

4) 本次发行的募集资金投资项目系甲方根据其目前自身实际情况拟进行的安排，该等安排可能会根据审批情况和市场情况等因素的变化由甲方在依法履行相关程序后做出相应调整，该等调整不构成甲方违约。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

(一) 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行人本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日联得装备股票交易均价的 80% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行股票采取询价发行方式，发行人本次非公开发行股票的具 体发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。聂泉先生不参与本次非公开发行股票的询价，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次非公开发行股票未能通过上述询价方式产生发行价格，则聂泉先生不参与本次认购。

发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方式如下：

派息： $P1 = P0 - D$

送股或转增股本： $P1 = P0 / (1 + N)$

派息和送股或转增股本同时进行： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

其中： $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派息， N 为每股送股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

若国家法律、法规对非公开发行业股票的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（二）发行数量

发行人拟以非公开方式向特定对象发行不超过 43,226,241 股人民币普通股（A 股）股票（具体以监管部门最终审核及注册数量为准），不超过本次非公开发行前发行人总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据监管部门相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

如发行人股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

（三）限售期

本次非公开发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人聂泉先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。通过本次非公开发行股票取得的公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

四、募集资金投向

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元。募集资金扣除发行

费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	本次募集资金拟投入额
1	汽车电子显示智能装备建设项目	24,000
2	大尺寸 TV 模组智能装备建设项目	16,000
3	半导体封测智能装备建设项目	16,000
4	补充流动资金项目	24,000
	合计	80,000

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行对象中包括聂泉先生，聂泉先生为公司控股股东、实际控制人，为本公司关联方，本次发行构成关联交易。

在本公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。在公司股东大会审议相关议案时，关联股东在股东大会上对本次发行相关事项已回避表决。

除聂泉先生外，本次发行尚未确定其他具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本为 144,087,472 股，聂泉先生直接持有公司 88,066,722 股股份，占公司总股本的 61.12%，为公司控股股东、实际控制人。按照本次非公开发行股票的数量上限 43,226,241 股、聂泉先生不参与认购进行测算，本次发行结束后，公司的总股本为 187,313,713 股，聂泉先生持有公司股权比例为 47.02%。

因此，本次发行完成后，上市公司实际控制人仍为聂泉先生，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议、**第三届董事会第二十六次会议**、2019年度股东大会审议通过。本次非公开发行方案尚需通过并获得监管部门审核及注册。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	本次募集资金拟投入额
1	汽车电子显示智能装备建设项目	24,000
2	大尺寸 TV 模组智能装备建设项目	16,000
3	半导体封测智能装备建设项目	16,000
4	补充流动资金项目	24,000
合计		80,000

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、募集资金项目的可行性分析

（一）下游行业发展迅速，为平板显示装备制造企业带来机遇

公司本次非公开发行股票募集资金并在东莞地区建设生产基地，在发行人现有产品的基础上进一步新增汽车电子显示、大尺寸智能电视、半导体封测等应用领域，进一步优化公司的产品结构、增加新的利润增长点并进一步增强公司的盈利能力。

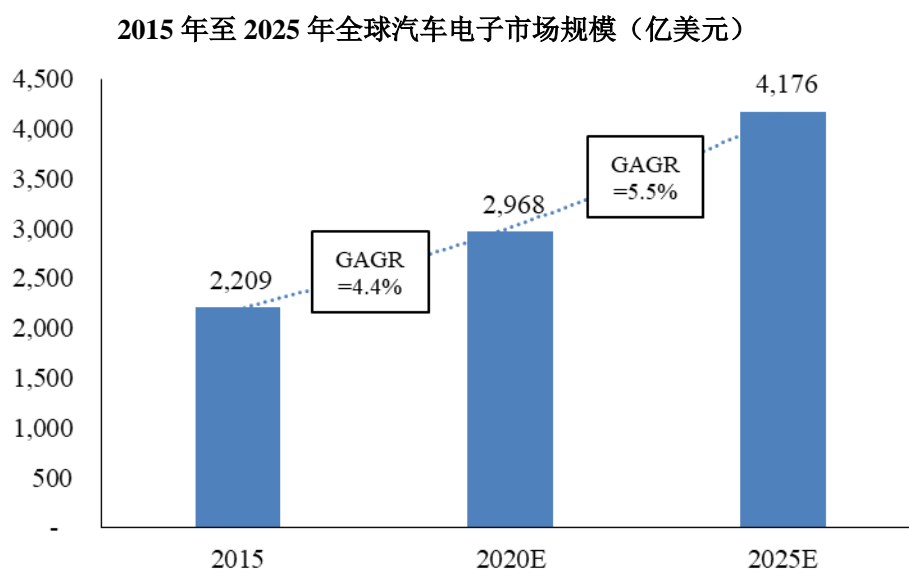
上述应用领域具有良好的发展前景和广阔的市场空间，具体情况如下：

1、汽车电子显示领域

在智能化、网联化及电子化的浪潮下，汽车已经从传统的机械产品发展为电子信息系统控制的智能产品。随着用户对汽车尾气排放、安全性、舒适性、

娱乐性的需求不断提高，以及自动驾驶系统、信息娱乐与网联系统部件的不断应用，汽车电子化已成为未来汽车工业发展的一大趋势。

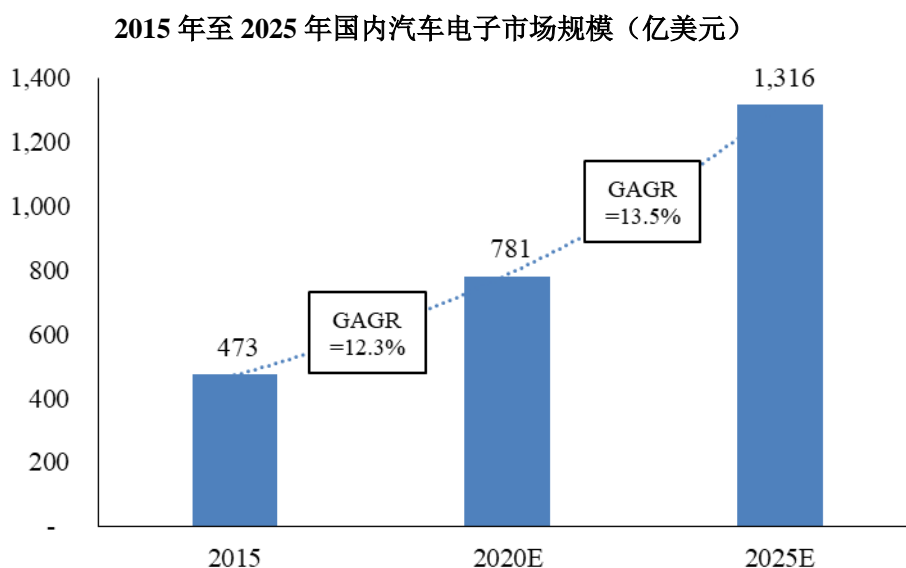
2015年，全球汽车电子市场规模为2,209亿美元。2020年，该市场规模预计达到2,968亿美元，并以5.5%的年均复合增长率在2025年增长至4,176亿美元。



数据来源：HIS、Strategy Analytics、中金公司研究报告

根据国务院发展研究中心发布的《中国汽车产业发展报告》，目前中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为10%，轿车电子产品成本比重已达10%~25%，世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达35%，未来国内汽车电子成本占总整车成本比例将有所提升，为汽车电子产业带来巨大的增量空间。

2015年，国内汽车电子市场规模为473亿美元。2020年，该市场规模预计达到781亿美元，并以13.5%的年均复合增长率在2025年增长至1,316亿美元。

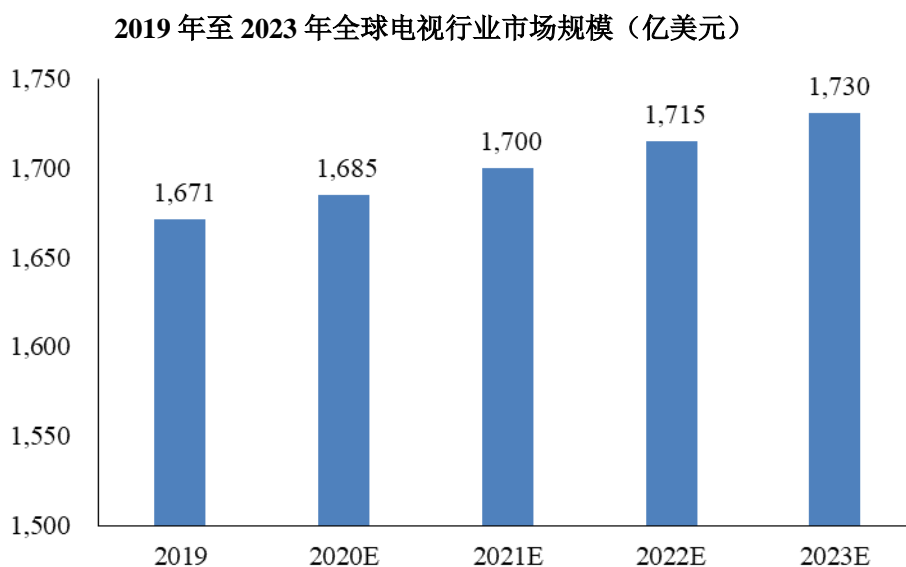


数据来源：HIS、Strategy Analytics、中金公司研究报告

2、大尺寸平板显示领域

随着移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术的不断成熟及迅猛发展，智能电视逐渐成为家庭重要的视听、娱乐和信息分享交互智能终端，市场需求持续增长，销售量不断攀升。根据 Strategy Analytics 数据，2018 年智能电视全球销量达到 1.57 亿台，占全年电视总销量的 67%。

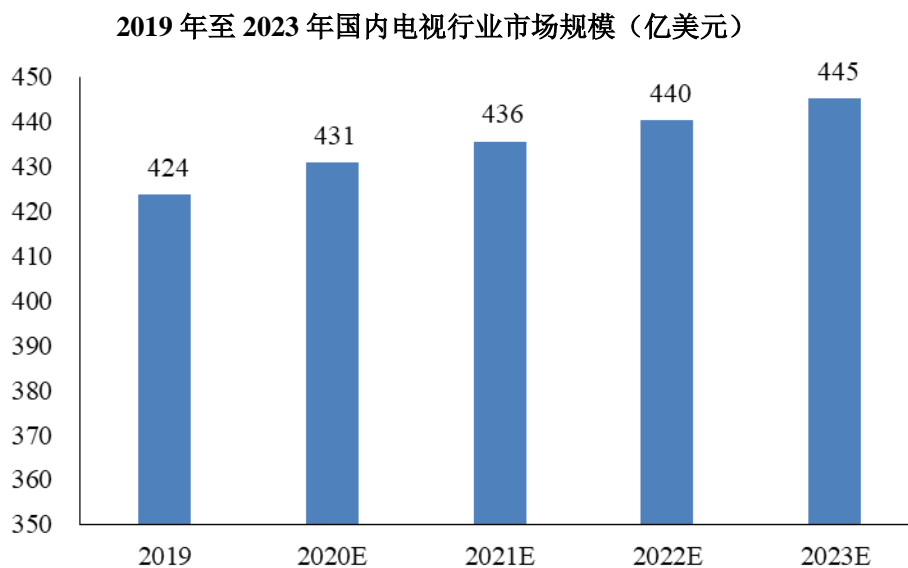
根据 Statista 数据，2019 年包括智能电视在内的全球电视行业市场规模为 1,671 亿美元，该市场规模预计在 2020 年达到 1,685 亿美元。



数据来源：Statista

与此同时，我国智能电视行业也在快速发展，主要传统电视厂商及华为、小米、OPPO、PPTV 等互联网企业均推出了智能电视品牌及产品。根据前瞻产业研究院数据，2014 年-2018 年，我国智能电视市场销量由 2,931 万台增长至 4,249 万台，复合增长率 9.37%，呈快速增长态势。

根据 Statista 数据，2019 年包括智能电视在内的国内电视行业市场规模为 424 亿美元，该市场规模预计在 2020 年达到 431 亿美元。



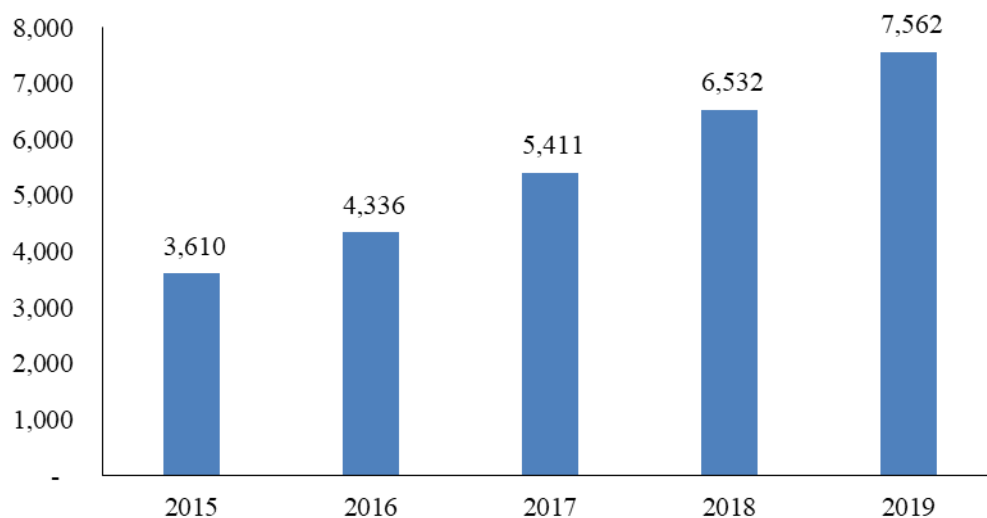
数据来源：Statista

3、半导体封测领域

半导体行业是电子信息产业的基础，位于电子行业的中游，上游为芯片制造、封测支撑性行业，下游为消费电子、通讯设备、汽车电子等硬件组装行业。半导体和其他元器件通过集成电路板连接，应用于个人电脑、智能手机、汽车电子等终端产品、承担信息的载体和传输功能，是信息化社会的重要基石之一。

根据世界半导体贸易统计组织 WSTS 统计，2019 年全球半导体产业市场规模为 4,121 亿美元，预计在 2020 年将增长至 4,330 亿美元，行业景气度良好，市场空间巨大。我国是全球半导体市场规模增速最快的国家之一。根据中国半导体行业协会统计，2018 年和 2019 年，我国半导体产业市场规模分别为 6,532 亿元和 7,562 亿元，同比增长率分别为 20.7% 和 15.8%，显著高于全球半导体产业市场增速。

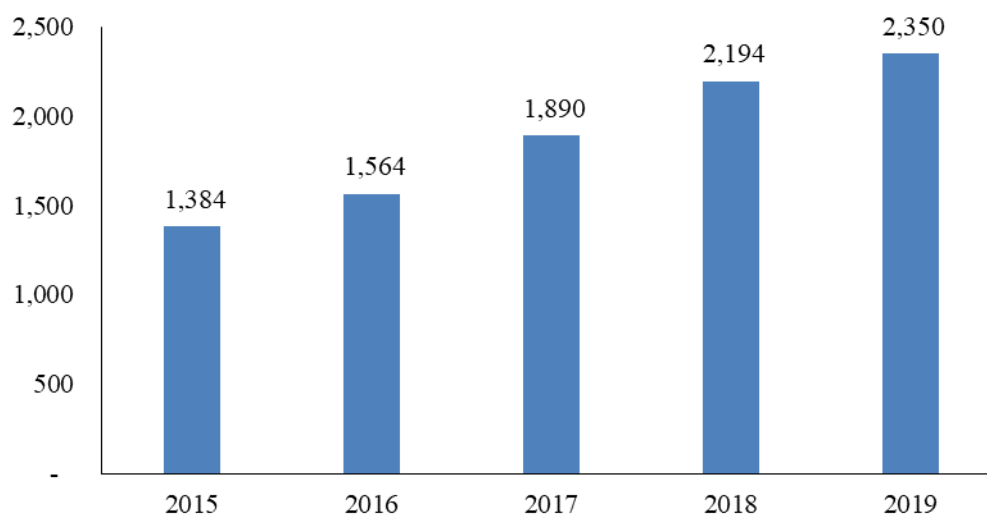
2015年至2019年国内半导体产业市场规模（亿元）



数据来源：中国半导体行业协会

半导体产业主要包括芯片设计、芯片制造和封装测试三个部分。封装测试是半导体产业链的最后一个环节，其中封装主要为保护芯片免受物理、化学等环境因素的伤害，增强芯片散热性能，实现电气连接并确保电路正常工作；测试主要为对芯片的功能、性能进行测试。我国半导体封测产业保持快速增长，根据中国半导体行业协会统计，2019年我国半导体封测产业规模为2,350亿元，占整体产业规模的31%。2015年至2019年，我国半导体封测产业规模复合增长率为14.15%。

2015年至2019年国内半导体封测产业市场规模（亿元）



数据来源：中国半导体行业协会

同时伴随全球众多晶圆厂项目的投入建设，大批新建晶圆厂产能的释放也将带来更多的半导体封测新增需求，推动半导体封测产业继续增长。

半导体产业作为信息产业的核心和基础，受到国家政策的大力支持，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》、《集成电路产业“十三五”发展规划》和《中国制造 2025》等相关政策的稳步推进，半导体产业及封测子产业有望迎来新的发展机遇。

由上述分析可知，目前全球及国内在汽车电子显示、大尺寸平板显示、半导体封测领域发展前景良好，为本次募投项目新增产品销售及产能消化提供了良好的市场保障。

（二）项目建设符合国家相关政策规划的要求

平板显示生产设备制造业是智能装备制造业的重要分支，平板显示生产装备制造业的发展进步对我国平板显示产业乃至电子信息产品制造业整体水平的发展和提升有着重要的意义。

在 2006 年国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中，就将“新型显示器件生产设备”列入需要重点突破的关键领域。2010 年以来，国家政府又制定了大量的产业政策引导和支持我国平板显示生产设备制造业的发展。比如 2010 年发布的《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，2011 年发布的《产业结构调整指导目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《工业转型升级规划（2011-2015 年）》，2012 年发布的《重大技术装备自主创新指导目录》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等，2015 年发布的《中国制造 2025》，2016 年发布的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》。此外，2011 年修订的《鼓励进口技术和产品目录（2011 年版）》和 2012 年修订的《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》还分别将平板显示生产设备及制造技术列入“鼓励引进的先进技术”和“免征进口关税和进口环节增值税”目录中，鼓励我国引进平板显示生产设备相关技术和产品。

此外，广东地方政府也出台了相关的产业政策，如《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》、《广东省智能制造发展规划（2015-2025年）》、深府〔2014〕96号《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划（2014—2020年）》、深府〔2014〕97号《深圳市人民政府关于印发机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展政策的通知》。

本项目的建设可以极大地提高企业在智能装备方面的生产能力、推动我国智能装备产业的发展，符合国家相关产业的扶持政策。

（三）发行人积累了丰富的客户资源、研发实力、质量和品牌优势及行业经验等，形成核心竞争力，为本次募集资金投资项目的顺利实施奠定了良好的基础

公司自成立以来，专注于平板显示器件及相关零组件生产设备的研发、生产、销售和服务，积累了深厚的技术储备和丰富的市场经验，树立了良好的市场形象和品牌知名度。

在客户资源及业务拓展方面，目前公司已经与富士康、京东方、华为、苹果、深天马、蓝思科技、华星光电、长信科技、立讯精密、维信诺、比亚迪等众多知名客户建立了良好的合作关系，积累了稳定优质的客户资源。同时公司积极拓展与本次募集资金投资项目相关的客户和业务资源。2020年1月公司成为欧洲大陆集团供应商并正式纳入其供应链体系，进一步拓展了公司产品线的应用领域和范围。同时公司积极进行大尺寸模组邦定设备及TV模组整线的研发拓展并顺利实现生产销售，加大半导体倒装等设备的研发投入，积极实现更多元化的业务布局。

在研发实力方面，公司为国家级高新技术企业，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。公司设立了邦定事业部、贴合事业部、移动终端事业部、AOI软体开发部、电子资讯部、视觉开发部、综合事业部、TV大尺寸部、半导体及光伏事业部等部门，构建了比较完善的研发体制，形成了持续、较强的研发创新能力。在持续加大研发投入、引进优秀技术人才的推动下，公司研发能力处于行业前列。

在品牌与质量方面，随着技术和服务水平的不断提升、品牌影响力的不断深化、以及市场的不断开拓，公司逐步确立了国内平板显示器件及相关零组件生产设备制造领域的优势地位，并凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势在业内树立了良好的口碑。目前，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，产品已服务于全球领先的知名平板显示产品生产企业并树立了良好的品牌知名度，为公司的持续发展和市场开拓奠定了良好的基础。

在行业经验方面，公司 2002 年就开始就从事平板显示器件及相关零组件生产设备制造，是我国较早进入该领域的企业。十余年来，公司经历了平板显示产业的多种技术变革，对平板显示产业各种知识体系和生产工艺进行了持续的深入钻研和探索，通过多年的技术沉淀和积累实现了平板显示产业各种技术之间的掌握和融合，积累了丰富的平板显示器件及相关零组件生产设备制造经验，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

公司凭借突出的研发和创新能力、优质的质量与品牌声誉、丰富的行业经验、深厚的客户资源等，市场地位逐步提升、市场竞争力不断增强。因此，本次募集资金投资项目实施前景明朗。

三、募集资金投资项目概况

(一) 汽车电子显示智能装备建设项目

1、项目建设内容

本项目建设期为 2 年，计划投资总额 28,525.37 万元。通过项目建设，公司将建设先进厂房并引进先进生产设备，形成自动曲面 CG 外观及光学设备、车载显示屏电性检查设备、自动曲面屏组装设备、汽车显示总装设备、汽车显示测试设备等智能装备生产能力，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。

2、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为上市公司全资子公司东莞联鹏，项目实施地址为广东

省东莞市塘厦镇，公司已取得了募集资金投资项目用地的土地使用权证。

本项目计划使用募集资金不超过 24,000.00 万元用于厂房建设、设备购置等，其余部分由公司自筹解决。本项目建成完全达产后，将实现营业收入 32,000 万元，具有良好的经济效益。

3、项目审批情况

截至目前，该项目的备案及环境影响评价手续已办理完毕。

4、预计实现营业收入的具体测算过程、测算依据

本次发行人向特定对象发行股票，计划使用募集资金不超过 24,000 万元用于“汽车电子显示智能装备建设项目”。该项目完全达产后，预计可新增年平均销售收入 32,000.00 万元。本项目营业收入的测算依据包括汽车电子显示市场的发展情况、产品的销售价格、公司产品竞争优势、营销策略等因素，具体测算过程如下：

本项目计算期为 12 年，其中建设期 2 年，运营期 10 年。从第 3 年开始投产并在第 4 年完全达产。本次募集资金投资项目的收益来源于自动曲面 CG 外观及光学设备、车载显示屏电性检查设备、自动曲面屏组装设备、汽车显示总装设备和的汽车显示测试设备的销售收入，具体测算过程如下：

单位：万元/套、套、万元

产品名称	项目	T3 年	T4-T12 年
自动曲面 CG 外观及光学设备	价格	200	200
	销量	17	24
	营业收入	3,400	4,800
车载显示屏电性检查设备	价格	100	100
	销量	18	26
	营业收入	1,800	2,600
自动曲面屏组装设备	价格	180	180
	销量	18	25
	营业收入	3,240	4,500
汽车显示总装设备	价格	1,200	1,200
	销量	6	8

产品名称	项目	T3年	T4-T12年
	营业收入	7,200	9,600
汽车显示测试设备	价格	1,500	1,500
	销量	5	7
	营业收入	7,500	10,500
营业收入合计(万元)		23,140	32,000

(二) 大尺寸 TV 模组智能装备建设项目

1、项目建设内容

本项目建设期为 2 年，计划投资总额 18,715.24 万元。通过项目建设，公司将建设先进厂房并引进先进生产设备，形成面板端子清洗设备、OLB 邦定设备、AOI 检测设备、DISP 封胶设备、PWB 绑定设备等智能装备生产能力，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。

2、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为上市公司全资子公司东莞联鹏，项目实施地址为广东省东莞市塘厦镇，公司已取得了募集资金投资项目用地的土地使用权证。

本项目计划使用募集资金不超过 16,000.00 万元用于厂房建设、设备购置等，其余部分由公司自筹解决。本项目建成完全达产后，将实现营业收入 22,850.00 万元，具有良好的经济效益。

3、项目审批情况

截至目前，该项目的备案及环境影响评价手续已办理完毕。

4、预计实现营业收入的具体测算过程、测算依据

本次发行人向特定对象发行股票，计划使用募集资金不超过 16,000 万元用于“大尺寸 TV 模组智能装备建设项目”。该项目完全达产后，预计可新增年平均销售收入 22,850.00 万元，本项目营业收入的测算依据包括大尺寸 TV 模组智能装备市场发展情况、产品的销售价格、公司产品的竞争优势、营销策略等因素。具体测算过程如下：

本项目计算期为 12 年，其中建设期 2 年，运营期 10 年。从第 3 年开始投产

并在第 4 年完全达产。本次募集资金投资项目的收益来源于面板端子清洗设备、OLB 邦定设备、AOI 检测设备、DISP 封胶设备与 PWB 绑定设备等智能装备的销售收入，具体测算过程如下：

单位：万元/套、套、万元

产品名称	项 目	T3 年	T4-T12 年
面板端子清洗设备	价格	220	220
	销量	7	10
	营业收入	1,540	2,200
OLB 邦定设备	价格	1,000	1,000
	销量	7	10
	营业收入	7,000	10,000
AOI 检测设备	价格	130	130
	销量	11	15
	营业收入	1,430	1,950
DISP 封胶设备	价格	130	130
	销量	11	15
	营业收入	1,430	1,950
PWB 绑定设备等智能装备	价格	450	450
	销量	11	15
	营业收入	4,950	6,750
营业收入合计（万元）		16,350	22,850

（三）半导体封测智能装备建设项目

1、项目建设内容

本项目建设期为 2 年，计划投资总额 19,515.52 万元。通过项目建设，公司将建设先进厂房并引进先进生产设备，形成 COF 倒装设备、IGBT 芯片及模组封装设备，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。

2、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为上市公司全资子公司东莞联鹏，项目实施地址为广东省东莞市塘厦镇，公司已取得了募集资金投资项目用地的土地使用权证。

本项目计划使用募集资金不超过 16,000.00 万元用于厂房建设、设备购置

等，其余部分由公司自筹解决。本项目建成完全达产后，将实现营业收入 23,000.00 万元，具有良好的经济效益。

3、项目审批情况

截至目前，该项目的备案及环境影响评价手续已办理完毕。

4、预计实现营业收入的具体测算过程、测算依据

本次发行人向特定对象发行股票，计划使用募集资金不超过 16,000 万元用于“半导体封测智能装备建设项目”。该项目完全达产后，预计可新增年平均销售收入 23,000.00 万元，本项目营业收入的测算依据包括半导体封测智能装备市场发展情况、产品的销售价格、公司产品的竞争优势、营销策略等因素。具体测算过程如下：

本项目计算期为 12 年，其中建设期 2 年，运营期 10 年。从第 3 年开始投产并在第 4 年完全达产。本次募集资金投资项目的收益来源于 COF 倒装设备和 IGBT 芯片及模组封装设备的销售收入，具体测算过程如下：

单位：万元/套、套、万元

产品名称	项目	T3 年	T4-T12 年
COF 倒装设备	价格	260	260
	销量	35	50
	营业收入	9,100	13,000
IGBT 芯片及模组封装设备	价格	200	200
	销量	35	50
	营业收入	7,000	10,000
营业收入合计（万元）		16,100	23,000

（四）补充流动资金项目

随着公司经营规模的增大，所需的营运资金量也不断增加，适度补充流动资金有助于公司缓解营运资金压力。公司本次非公开发行股票拟使用募集资金不超过 24,000.00 万元用于补充流动资金。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有资金情况、实际营运资金缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

（五）募投项目建设进展、募集资金使用进度安排

1、募投项目的建设进展情况

截至本募集说明书签署之日，汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目、半导体封测智能装备建设项目均已经完成备案立项、环评批复等程序。截至目前上述项目已经开始实施建设，自本次发行相关董事会召开日至今，发行人已经使用自有资金对上述项目累计投入金额 2,428.43 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	名称	董事会召开日至今累计投入情况
1	汽车电子显示智能装备建设项目	1,040.75
2	大尺寸TV模组智能装备建设项目	676.49
3	半导体封测智能装备建设项目	711.18
	合计	2,428.43

截至本回复出具之日，“补充流动资金项目”尚未开始实施。

2、本次募集资金的使用进度安排

本次募集资金投资项目中，汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目、半导体封测智能装备建设项目的建设期均为2年，建设进度保持一致。上述项目具体的建设实施进度情况如下：

序号	进度阶段	第一年						第二年					
		1-2月	3-4月	5-6月	7-8月	9-10月	11-12月	1-2月	3-4月	5-6月	7-8月	9-10月	11-12月
1	清理场地	√	√										
2	工程及设备招标		√										
3	基础建设及装修工程			√	√	√	√						
4	设备采购及安装调试							√	√	√	√	√	
5	人员招聘及培训										√	√	√
6	试生产											√	√
7	验收竣工												√

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的 24,000 万元用于补充流动资金，将于募集资金到位后一次性补充公司流动资金。

四、本次非公开发行对公司的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金不超过 80,000.00 万元，募集资金投资项目的顺利实施将有效地提升公司的生产能力、实现产品结构的升级及多元化，为公司实现发展战略目标奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后，将为公司的进一步发展提供资金保障。公司资本实力大大增强，本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目投产后，公司的营业收入和净利润将进一步提升，盈利能力得到进一步的改善，公司的整体业绩水平将得到稳步提升。

第五节 本次募集资金收购资产的有关情况

本次募集资金投资项目不涉及收购资产。

第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次非公开发行股票募集资金不超过 80,000.00 万元，募集资金投资项目的顺利实施将有效地提升公司的生产能力、实现产品结构的升级及多元化，为公司实现发展战略目标奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，预计增加有限售的流通股不超过 43,226,241 股，导致公司股本总额和注册资本发生变化。公司需要根据发行结果修改公司章程所记载的股本总额和注册资本等相关条款，并办理工商变更手续。

（三）本次发行对公司股东结构的影响

截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本为 144,087,472 股，聂泉先生直接持有公司 88,066,722 股股份，占公司总股本的 61.12%，为公司控股股东、实际控制人。按照本次非公开发行股票的数量上限 43,226,241 股、聂泉先生不参与认购进行测算，本次发行结束后，公司的总股本为 187,313,713 股，聂泉先生持有公司股权比例为 47.02%。

因此，本次发行完成后，上市公司实际控制人仍为聂泉先生，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对高管人员结构造成重大影响，若公司拟调整高级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动分析

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的流动资产、总资产、净资产将大幅增加，营运资金情况将得到较大改善。公司资本实力得到增强、资本结构更加稳健，经营抗风险能力将进一步加强。本次发行有助于增强公司资金实力，为后续发展提供有力保障。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司净资产和总股本将有所增加，而募集资金投资项目的效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募投项目的逐步建成达产，公司的盈利能力、经营业绩将会逐步提高，整体的盈利能力将得到提升。

（三）本次发行对公司现金流的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金投资项目的实施，投资活动产生的现金流出将有所增长。而随着募集资金投资项目效益的产生，经营活动产生的现金流入将增加，公司现金流量状况将得到进一步优化。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司控股股东仍为聂泉，不会导致公司与聂泉及其关联人之间的业务关系、管理关系及同业竞争等方面发生变化。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司不会因本次非公开发行股票而产生资金、资产被控股股东及其关联人违规占用的情形，亦不会因本次非公开发行股票产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

第七节 与本次发行相关的风险因素

一、募集资金投资项目实施风险

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元，本次募集资金投资项目符合公司长期发展战略，有利于公司切入新的市场领域、优化产品结构，拓展新的利润增长点并将提高公司的盈利能力。公司在确定投资项目之前进行了缜密分析和科学设计，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但未来若出现产业政策变化、市场环境变化，可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利影响。

二、行业竞争加剧的风险

本公司所属行业为电子工业专用设备制造业。近年来智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子行业的发展带动平板显示行业迅速扩张，对于平板显示器件及相关零组件生产设备的需求也日益增多。部分境外先进设备供应商相继进入大陆市场并设立分支机构或生产基地，同时国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业也取得较大发展，国内市场竞争日益激烈。伴随行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应及对市场需求的敏感度或技术开发无法紧密契合市场需求，则有可能导致本公司的市场地位下降。

三、受下游市场波动影响的风险

本公司目前产品主要为平板显示模组组装设备，主要下游客户为国内外较知名的平板显示器件和零组件生产企业，该类客户产品主要应用于智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子产品。尽管近年来国内外消费类电子产品市场发展迅速，但影响消费类电子产品长期市场需求变动趋势的因素非常多，如经济周期、消费偏好、市场热点、技术进步等，受各项因素影响，消费类电子产品市场需求也会呈现非常规的波动，进而影响本公司下游客户的产能、产量，从而影响本公司产品的市场需求，本公司产品销量或产品价格面临波动的风险。若平板显示器件主要应用市场需求增长趋势放缓，则可能对公司经营业绩

产生不利影响。

四、财务风险

公司 2017 年、2018 年和 2019 年营业收入分别为 46,627.92 万元、66,359.17 万元和 68,863.74 万元，归属于母公司股东净利润分别为 5,652.25 万元、8,527.04 万元和 8,086.53 万元。本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施将有效地提升公司的生产能力、实现产品结构升级，为公司实现发展战略目标奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力及盈利能力，为股东创造经济价值。如果公司无法保持现在的健康运营状态以及高效的盈利能力，上述折旧摊销将对公司盈利情况产生影响。

五、管理风险

公司自成立以来，积累了较为丰富的、适应公司发展的经营管理经验，建立了有效的约束机制和内部管理制度，法人治理结构不断得到完善。但是，随着公司本次非公开发行成功，公司的经营规模和生产能力将进一步扩大，对公司的生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司人才储备及管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将对公司产生不利影响。此外，关键管理人员的流失或变动也将对公司管理带来风险。

六、即期回报被摊薄的风险

本次非公开发行股票募集资金投资项目建成投产后，公司的生产能力将显著上升、产品结构将得到进一步改善。本次募集资金投资项目的实施将有效提升公司技术水平，进一步提升公司的持续盈利能力。考虑到募投项目从投产到达产需要一定的过程和时间，因此在产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务。因此，在本次非公开发行后，公司在总股本和净资产有所增长的情况下，每股收益在短期内存在被摊薄的风险。

七、审批风险

本次发行方案尚需取得监管部门审核及注册。上述呈报事项能否获得相关审核通过或注册，以及获得相关审核通过或注册的时间，均存在不确定性，提请广

大投资者注意审批风险。

八、应收账款金额不断扩大的风险

报告期内伴随公司业务规模不断扩大，应收账款规模也相应增长。报告期各期末公司应收账款账面金额分别为 13,518.31 万元、25,309.92 万元、29,562.25 万元、38,144.87 万元，占当期末资产总额的比例分别为 12.99%、21.77%、20.29%、24.50%。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，存在应收账款出现逾期或无法收回而发生坏账的可能，从而对公司业绩和生产经营产生影响。

九、存货管理的风险

报告期内伴随公司业务规模不断扩大，期末存货金额也相应增长。报告期各期末公司存货余额分别为 22,883.79 万元、35,736.38 万元、38,846.22 万元、36,823.97 万元，占当期末资产总额的比例分别为 21.99%、30.74%、26.66%、23.65%。随着公司经营规模的扩大，存货余额可能会进一步增加，如果公司不能继续保持对存货的良好管理，则会导致存货大规模增加从而影响公司资金周转率和利用率或产生存货跌价的风险，从而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

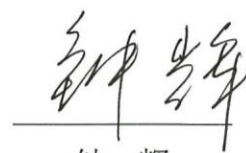
发行人全体董事及高级管理人员声明：



聂泉



刘文生



钟辉



曾细根



娄超



杨文

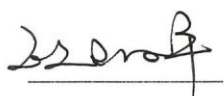
深圳市联得自动化装备股份有限公司



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

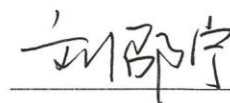
发行人全体监事声明：



欧阳小平



邹毅



刘邵宁

深圳市联得自动化装备股份有限公司



2020年9月8日

二、控股股东、实际控制人声明

本人为深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东、实际控制人。本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：

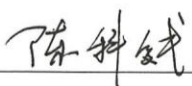


聂 泉

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：


陈科斌

保荐代表人：


刘俊清


郝智明

保荐机构首席执行官、
法定代表人：


马 骥

保荐机构董事长：


潘鑫军

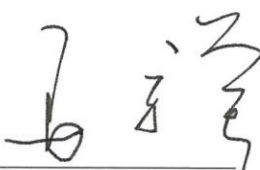

东方证券承销保荐有限公司
2020年9月8日

三、保荐机构（主承销商）声明（二）


本人已认真阅读深圳市联得自动化装备股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构首席执行官、

法定代表人：


马 骥

保荐机构董事长：


潘鑫军

东方证券承销保荐有限公司

2020年 9 月 8 日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



负责人：

张 炯



经办律师：

曹平生



孙伟博



2020年9月8日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板非公开发行A股股票募集说明书》(以下简称募集说明书),确认募集说明书与本所出具的大信审字[2020]第5-00058号审计报告、大信专审字[2020]第5-00051号内控鉴证报告、大信专审字[2020]第5-00085号前次募集资金使用情况审核报告及大信专审字[2020]第5-00109号非经常性损益审核报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对深圳市联得自动化装备股份有限公司在募集说明书中引用的上述审计报告、内控鉴证报告、前次募集资金使用情况审核报告及非经常性损益审核报告的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人:




胡咏华

签字注册会计师:




(项目合伙人)

陈善佩

签字注册会计师:




张引君

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



2020年9月8日

第九节 与本次发行相关的董事会声明及承诺

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次非公开发行外，公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展及资产负债状况需要安排股权融资，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1、主要假设和前提条件

- （1）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
- （2）假设公司于2020年11月之前完成本次发行。该时间仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以监管部门审核及注册后实际发行完成时间为准；
- （3）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况的影响；
- （4）本次非公开发行股票募集资金总额为80,000.00万元，不考虑发行费用的影响；假设按照本次非公开发行股票数量上限计算，本次非公开发行的

43,226,241 股；

(5) 在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 144,087,472 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

(6) 在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润及分红之外的其他因素对净资产的影响。

(7) 公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,086.53 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 7,537.09 万元；分别按照 2020 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比 2019 年持平、上升 20% 进行测算。

上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2020 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日			
		2020 年净利润与上年持平		2020 年净利润较上年增长 20%	
		本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	14,408.75	14,408.75	18,731.37	14,408.75	18,731.37
归属于母公司 股东权益合计 （万元）	72,106.63	78,752.28	158,752.28	80,369.59	160,369.59
归属于母公司 所有者的净利 润（万元）	8,086.53	8,086.53	8,086.53	9,703.84	9,703.84
扣除非经常性 损益后归属于 母公司所有者 的净利润（万 元）	7,537.09	7,537.09	7,537.09	9,044.51	9,044.51
基本每股收益 （元/股）	0.56	0.56	0.55	0.66	0.66

稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.54	0.53	0.63	0.63
扣除非经常性 损益基本每股 收益(元/股)	0.53	0.52	0.51	0.61	0.61
扣除非经常性 损益后稀释每 股收益(元/股)	0.53	0.50	0.49	0.59	0.59
加权平均净资 产收益率	12.88%	10.72%	9.85%	12.73%	11.70%
扣除非经常性 损益加权平均 净资产收益率	12.01%	9.99%	9.18%	11.86%	10.91%

注：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算方式计算。

（二）本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析

本次非公开发行募集资金投资项目的顺利实施将有效地提升公司的生产能力、实现产品结构的升级及多元化，为公司实现发展战略目标奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

本次非公开发行 A 股股票发行结束后，募集资金投资项目实现利润需要一定的时间，将对公司普通股股东即期回报产生摊薄影响。

（三）本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长。本次募投项目的实施将进一步优化公司的产品结构、提升公司的生产能力，增强公司的盈利能力和综合竞争力。但考虑到募投项目从投产到达产需要一定的过程和时间，且产生效益的金额受宏观环境、企业经营、行业发展等多种因素的影响，因此在产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益在短期内存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。

（四）公司保证本次募集资金有效使用、防范摊薄即期回报、提高未来回报能力的措施

考虑到本次非公开发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国

务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保护普通股股东的利益，填补非公开发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险并提高未来的回报能力。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

具体措施如下：

1、加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》。本次非公开发行募集资金到位后，将存放于董事会决定的专户集中管理，保障募集资金用于指定的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险同时提高使用效率。

2、提升公司经营效率，降低运营成本

公司将进一步加强质量控制，持续优化业务流程和内部控制制度，对各个业务环节进行标准化管理和控制。在日常经营管理中，公司将进一步加强对采购、生产、销售、研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作，提升资产运营效率、降低公司营运成本，从而提升公司盈利能力。

3、加大市场开拓力度，提升盈利能力

公司将利用在行业的竞争优势，深入挖掘客户需求、提高客户满意度，加强与重要客户的深度合作，形成长期战略合作伙伴关系。公司将坚持以市场为中心，依据市场规律和规则组织生产和营销。公司将进一步提高营销队伍整体素质。公司将通过加大市场开拓力度，不断完善营销网络体系及激励机制，提升对本次募集资金投资项目新增产能的消化能力，提高市场占有率，进一步增强公司盈利能力。

4、加快募集资金投资项目建设，提升公司核心竞争力

公司将严格按照董事会及股东大会审议通过的募集资金用途使用募集资金。本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作，积极调配资源、统筹合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产并实现预期效益，使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

5、严格执行现金分红，保障投资者利益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次非公开发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

（五）公司相关主体对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。”

2、公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东、实际控制人聂泉根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定，承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”